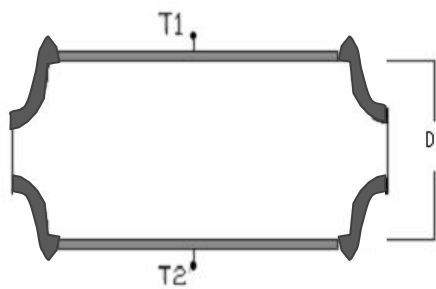
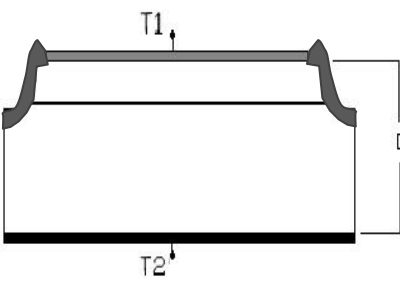
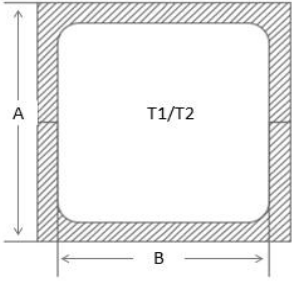


## 描述

TVS 系列产品是一种专门用来保护敏感电子设备免受雷电或者瞬态电压冲击的器件。

- 低漏电流
- 快速相应速度 (从 0->VBR 响应时间小于 1ps)
- 玻璃钝化结
- 良好的钳位能力
- 叠料承受 5000W 峰值脉冲 (10/1000 $\mu$ s)

## 芯片结构图

芯片工艺 Wafer tech	台面玻璃钝化工艺	
圆片尺寸 Wafer Size	$\Phi$ 5inch	
划片宽度 Scribe Lane Width	300 $\mu$ m	
满版点数 Die Per Wafer	651	
芯片厚度 Chip Thickness	D=265 $\pm$ 15 $\mu$ m D=220 $\pm$ 15 $\mu$ m (220 $\geq$ VR>90, 单向) (可根据客户要求定制)	
金属 (T1/T2) Metal	正面 Front	TiNiAg
	背面 Back	TiNiAg
芯片尺寸 Chip Size	芯片尺寸(A: $\mu$ m) Chip	4064 $\pm$ 50
	电极尺寸(B: $\mu$ m) Pad	3521 (+25, -50; VR<11V) 3744 (+25, -50; VR $\geq$ 11V)
  		
<p>(图 1: 双向 TVS 外沟槽结构示意图)      (图 2: 单向 TVS 外沟槽结构示意图)      (图 3: 芯片尺寸示意图)</p>		

## 芯片电参数-TVS (VR)

单向 Uni	双向 Bi	$V_{RWM}$	$V_{BR} @ I_T$		$I_T$	$V_C @ I_{pp}$	$I_{pp}$	$I_R @ V_{RWM}$
		(V)	(V)min	(V)max				
/	LM516V5C-160	16.5	17.8	19.7	1	26	115.4	1

### NOTICE

Leiditech reserves the right to make modifications,enhancements,improvements,corrections or other changes without further notice to any product herein. Leiditech does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein.